

Materiali	Condizionamento	Primer	Adesione a:	
<p>Ceramica</p> <ul style="list-style-type: none"> Ceramica a base di silicato (CAD-Blanks/Mark II/ Disilicato di litio/Vetroceramica) Ceramica da stratificazione/pressata. 	<p>Nel cavo orale: irruvidire con una fresa diamantata a granulometria grossa – a secco. Non mettere a contatto con acqua!</p> <p>Al di fuori del cavo orale: sabbviare con 110 µm di biossido di alluminio.</p> <p>Zirconio max. 2 bar Leghe non nobili/ titanio/CoCr da 3 a 4 bar</p>	 <p>Primer K applicare 2 volte e lasciare asciugare REF APK25003</p>	<p>Composito</p>	
<p>Metallo/Titanio</p> <ul style="list-style-type: none"> Leghe CoCr (leghe prive di metalli nobili/leghe non nobili) Leghe al titanio 		 <p>Primer MKZ REF MKZ02004</p>		<p>Opaco Zirkonliner</p>
<p>Zirconio</p> <ul style="list-style-type: none"> Ossido di zirconio (ossido di alluminio/Ceramica Spinell) 		<p>Zirconio max. 2 bar Leghe non nobili/ titanio/CoCr da 3 a 4 bar</p>	 <p>Primer MKZ REF MKZ02004 Attivatore MKZ EM REF MKZEM004</p>	<p>Opaco</p>
<p>Leghe auree</p> <ul style="list-style-type: none"> Leghe auree (Au/Ag/Pt/Pd) Eco-leghe (leghe a ridotto contenuto aureo) 			<p>Zirconio max. 2 bar Leghe non nobili/ titanio/CoCr da 3 a 4 bar</p>	 <p>visio.link REF VLPMMMA10 Applicare uno strato sottile</p>

Lasciare asciugare per ca. 30 secondi
Non utilizzare montai in vetro od in ceramica!

Fotopolimerizzare
90 secondi
370 - 500 nm

Applicare uno strato sottile di composito/opaco,
Fotopolimerizzare con lampade alogene o a LED per 30 secondi.

Applicare il composito crea.lign in strati sottili, rimuovere lo strato d'imbizione con alcol. Lucidatura e brillantatura.

Protocollo: Odt. Stephan Adler, Landsberg/Lech (DE)

1. Chipping della ceramica con struttura non esposta

- Rimuovere le impurità dalle superfici (deposito di placca/decolorazione).
- Irruvidire le superfici da riparare con una fresa diamantata a granulometria grossa (a secco), o sabbiare.

Non sciacquare con acqua o vaporizzare.

- Applicare uno strato spesso di primer K, la superficie non deve apparire „umida“.
- Attendere ca. 30 secondi, fino a che la superficie sia asciutta.
- Applicare il composito crea.lign (dentina/incisale...) nel colore corrispondente.
- Rimuovere lo strato d'inibizione (p.es. con alcol).
- Lucidare le zone riparate in 2 fasi (lucidatura e brillantatura).



Ceramica da rivestimento
Ceramica a base di silicato
Ceramica pressofusa

2. Chipping della ceramica con struttura esposta

- Rimuovere le impurità dalle superfici (deposito di placca/decolorazione).
- Irruvidire le superfici da riparare con una fresa diamantata a granulometria grossa (a secco), o sabbiare.
- **Non sciacquare con acqua o vaporizzare.**
- Se l'opaco è rimasto sul manufatto, non rimuoverlo ed eventualmente irruvidire.
- Applicare uno strato spesso di primer MKZ sul manufatto in metallo od in zirconio, l'opaco e la ceramica da rivestimento nelle zone adiacenti.
- Attendere ca. 30 secondi, fino a che la superficie sia asciutta.
- Applicare l'opaco di colore naturale sul manufatto, nel caso di manufatti in zirconio infiltrato è possibile utilizzare il Zirkonliner. Infine fotopolimerizzare con una lampada alogena o a LED.
- Applicare il composito crea.lign dentina ed incisale nel colore corrispondente, provvedere ad una fotopolimerizzazione intermedia dei diversi strati.
- Rimuovere lo strato d'inibizione (p.es. con alcol).
- Lucidare le zone riparate in 2 fasi (lucidatura e brillantatura).



CoCr
Ti

ZrO₂
AlO₃

In caso di chipping fino alla lega aurea del manufatto è necessario miscelare l'attivatore MKZ EM con il primer MKZ 1:1 ed applicarlo sul metallo e sulle zone adiacenti in ceramica.



+



Au, Ag, Pt, Pd

